**經濟部工業局108年電子設備產業推動計畫**

格式

附件 2

**海外技術專家來臺技術交流申請表**

1. **公司基本資料 Company Information**

**填表日期：108年 月 日**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名稱(Name of Company) |  |
| 主要營業項目(Business Items) |  |
| 主要市場(Major Markets) |  |
| 資本額(Capital) |  |
| 營收(Revenue) |  |
| 研發投入(Investment of R&D) |  |
| 研發人數(Number of R&D) |  |
| 公司地址(Address) |  |
| 連絡人(Contact Window) |  |
| 連絡電話(Tel / Cell Phone) |  |
| 電子郵件(e-mail) |  |
| 公司網站(Company Website) |  |
| 產品相關性(Product Relevance) | 是否為電子設備所需之設備、模組或零組件 ?□是□否  |

1. **技術需求與效益預估(Technical requirements and benefits estimation)**

|  |  |
| --- | --- |
| **需求技術領域或規格** | *­­­­­­­­­請簡述需求之技術領域或項目***範例 : ▓ 真空技術，高真空閥及真空泵開發** □ **1. 機構設計技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **2. 電控設計技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **3. 系統測試技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **4. 資通訊整合技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **5. 雲端運算技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **6. 巨量數據技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **7. 產品開發顧問，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **8. 雷射技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **9. 真空技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **10.光學技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **11.曝光製程技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **12.特殊金屬加工技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **13.成膜技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **14.蝕刻技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **15.銲線技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **16.定位控制技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **17.精密塗佈技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **18.機械手臂技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **19.電鍍製程技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **20.熱處理製程技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **21.研磨製程技術，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ **22.其它，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****­­­­­­­** |
| **預估效益** | **增加產值(元)** |  |
| **促進投資(元)** |  |
| **降低成本(元)**  |  |
| **可增加就業人口（人）** |  |
| **資格證明文件** | □公司登記或商業登記之證明文件 |
| 申請企業保證所附資料文件均屬正確，如有不實願負一切責任，受理單位得駁回其申請或依職權撤銷資格。公司章：＿\_\_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　申請人簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　中華民國　　　年　　　月　　　日 |
| **備註** |  |
| 1. 申請廠商需如實填寫本申請表格。
2. 財團法人金屬工業研究發展中心得視實際情況安排訪廠行程。
3. 本案連絡窗口資訊 :

受理窗口: 范專員 (02)27096987 # 511fannaiwen@mail.mirdc.org.tw |

經濟部工業局108年度

格式

附件 3

電子設備產業推動計畫

協助廠商確認書

　　茲證明本年度承財團法人金屬工業研究發展中心協助下列事項：

工作項目：促成海外專家來臺技術交流∕國際合作
合作內容：針對電子設備產業技術缺口，協助媒合與海外研究單位或廠商，進行海外技術專家來臺技術交流之國際合作。

　　　此　　致

經濟部工業局

廠 商 名 稱：

統 編：

申請人 簽名：

職　　 稱：

公 司 地 址：

電 話 傳 真：

中華民國 108 年 月　 日

格式

附件 4

**財團法人金屬工業研究發展中心**

**個人資料特定目的外利用同意書**

**特定目的外利用告知事項**

財團法人金屬工業研究發展中心(以下簡稱本中心)為遵守個人資料保護法，並保障當事人權益，茲依法告知下列事項：

(一)原蒐集之特定目的：國內設備廠商缺口需求訪廠調查事宜及現場技術診斷服務。

(二)其他利用之特定目的：經濟部工業局產業推動及計畫相關事宜。

(三)個資類別：辨識個人者如姓名、職稱、聯絡方式、地址等。

現行之受僱情形如公司名稱、部門、職稱等。

(四)個人資料利用之期間、地區、對象及方式

1. 本中心將於蒐集目的之存續期間內，合理利用您的個人資料。

2. 除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本中心僅於中華民國領域內利用您的個人資料。

3. 本中心將於原蒐集與其他利用之特定目的，以及其他公務機關請求與本中心創設目的相關之行政協助目的範圍內，合理利用您的個人資料。

(五)當事人權利：您可向本中心「個資當事人權利行使窗口」行使查詢或請求閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料之權利，電話：07-3513121轉2360。

(六)不同意之權益影響：若您不同意，本中心將無法提供您特定目的範圍外之相關服務。

(七)本中心因業務需要而委託其他單位處理您的個人資料時，將會善盡監督之責。

**個人資料之同意事項**

本人已充分知悉上述之告知事項，並同意貴中心在符合上述告知事項範圍內蒐集、處理及利用本人個人資料。

立書人簽名：

日 期： 年 月 日